

2026 年 8 月 26 日

致各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社

代表人 总裁 山崎秀和

所在地 京都府向日市 Nidec Park33 番地 C 栋

尼得科精密检测科技株式会社将参展 SEMICON TAIWAN 2026

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参加 SEMICON TAIWAN 2026。该展会为亚洲规模最大的半导体行业国际展会，集中展示半导体行业前沿技术与创新成果，将于 2026 年 9 月 2 日（周三）至 9 月 4 日（周五），在中国台北南港展览馆（TaiNEX）举办。



该展会是中国台湾地区最具影响力的半导体行业盛会之一，本届展会以“Transform Tomorrow”为主题，预计将有来自 65 个国家的 1,300 余家企业参展。

本公司以“ONE STOP SOLUTIONS of AI server/EVs”为主题，将推出涵盖前沿半导体封装全部工艺环节的检测解决方案。该方案以晶圆检测治具“探针卡”的新一代解决方案为核心，融合本公司引以为傲的光学检测技术、电气检测技术与探针测试技术，覆盖晶圆、芯片、基板直至封装件各环节。此外，还将同步展示需求近年持续增长的功率半导体专用检测设备以及搬运机器人。

〈参展概要〉

- 会期：2026 年 9 月 2 日(周三)～9 月 4 日(周五)
- 会场：中国台湾台北南港展示中心（TaiNEX 1）
- 展位：Hall11 K3276

〈参展内容〉

- 面向 CIS/Merory 的“2D MEMS 探针卡”
- 支持-40℃～200℃测量的“TC 探针”

- 适配高端器件、最小间距 60 μm 的 “MEMS FLEX 探针卡”
- 支持高压的加压结构型 “腔室头部探针卡”
- 适配细间距 40 μm 的 “Veri MEMS 探针卡”
- 支持大电流 2,300mA 的 “垂直型大电流探针卡”
- 面向 FOPLP/RDL 的高精度导通检测设备 “GATS®-7886”
- 面向大型单颗半导体封装的高精度导通检测设备 “GATS®-7837”
- 半导体封装多连片整板基板导通检测设备 “GATS®-8370”
- 适配窄间距的治具解决方案 “NS 探针”
- 适配晶圆凸点的光学式 2D/3D 检测设备 “RWi 系列”
- 适配高密度基板的 2D/3D 检测设备 “RSH 系列”
- 面向光模块、大型基板的新一代 AI 外观检测设备 “AURCA Series”
- 面向 TGV (Through Glass Via) 的高精度检测解决方案
- 晶圆搬运机器人系统 “AVR SMV 3000” ※与尼得科仪器联合开发